



レーザーが拓く 未来の鼓動をキャッチ!

established in 1972

## 第40回 レーザ協会セミナー

# 「光工具としてのレーザー加工」

主催：レーザー協会

協賛：光産業技術振興協会、日刊工業新聞、日本機械学会、精密工学会、  
レーザー学会、砥粒加工学会、レーザー加工学会

日時：平成28年11月24日(木)10:30～16:50

会場：中央大学 駿河台記念館 610 会議室

〒101-8324 東京都千代田区神田駿河台 3-11-5

<http://www.chuo-u.ac.jp/access/surugadai/>



10:30～10:35 開会挨拶 レーザ協会会長 新井 武二

10:35～11:15 講演1 「プリント基板の穴あけ加工の最新動向」

三菱電機(株) 名古屋製作所レーザー製造部 専任 伊藤 健治氏

11:15～11:55 講演2 「加工用レーザーの歯科補綴への応用」

日本歯科用レーザー・ライト学会 会長 南里 嶽仁氏

12:00～13:00 休憩

13:00～13:40 講演3 「高出力ファイバレーザー技術」

(株)フジクラ ファイバレーザー事業 部長 金田 恵司氏

13:40～14:30 特別招待講演 「Additive Manufacturing in LAMC/TRI and  
(通訳付) the Development for a Medical Implant Device」

工業技術研究院 雷射與積層製造科技中心 センター長 曹 芳海氏

14:30～14:45 休憩

14:45～15:25 講演4 「量産品製造に向けたパウダーベッドフュージョン型積層造形の研究」

産業技術総合研究所 機能造形研究 Gr. 佐藤 直子氏

15:25～16:05 講演5 「A.M.におけるレーザー加工と切削加工のハイブリッド加工機について」

DMG 森精機 先端加工技術部 部長 近藤 昌樹氏

16:05～16:45 講演6 「3D 金属積層造形システムと構造物」

愛知産業(株) 東京営業本部 先進機能部 主査 木寺 正晃氏

16:45～16:50 閉会挨拶

定員：100名

参加費：会員：10,000円、協賛会員：20,000円 非会員：25,000円、学生：4,000円(テキスト無し)

申込締切日：平成28年11月17日(木) (※協賛会員は所属団体を明記ください)

申込方法：レーザー協会 HP からできます。(<http://jslt.jp/>)

問合せ先：レーザー協会事務局 (メールでお願いします)